

证券代码：688536

证券简称：思瑞浦

公告编号：2025-022

转债代码：118500

转债简称：思瑞定转

## 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

### 关于部分募集资金投资项目延期

### 及调整内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》，同意公司根据募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施的需要，对部分募投项目延期及调整内部投资结构。本议案无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

#### 一、首次公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年8月18日签发的证监许可[2020]1824号文《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股20,000,000股，每股发行价格为人民币115.71元，股款以人民币缴足，计人民币2,314,200,000.00元。公司共计支付承销保荐费用含增值税金额计人民币161,901,432.00元（不含增值税金额为人民币152,737,200.00元），扣除此项承销保荐费用含增值税金额后，实际收到募集资金计人民币2,152,298,568.00元，存入募集资金专户，上述资金于2020年9月15日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永道中天验字(2020)第0818号验资报告。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销保荐费用以及其他发行费用）人民币168,453,425.35元后的净额为人民币2,145,746,574.65元。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，经董事会决议，公司设立了募集资金专项账户。公司及相关全资子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构海通证券股份有限公司（现吸收合并为“国泰海通证券股份有限公司”，海通证券股份有限公司对外签署的协议均由国泰海通证券股

份有限公司继续履行)、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方或四方监管协议。

根据公司 IPO 招股说明书首发募集资金使用计划, 以及公司使用 IPO 超募资金投资建设项目及永久补充流动资金情况, 公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

类别	募投项目名称	募集资金计划投资额 (万元)
首发募集资金投资项目	模拟集成电路产品开发与产业化项目	360,000,000
	研发中心建设项目	235,000,000
	补充流动资金项目	255,000,000
超募资金投资项目	永久补充流动资金	386,795,700
	车规级模拟芯片研发及产业化项目	685,141,100
	高性能电源芯片研发及产业化项目	291,235,400
金额合计		2,213,172,200

## 二、首次公开发行股票募集资金的使用情况

截至 2025 年 3 月 31 日, 公司首次公开发行股票募集资金投资项目合计投入 195,244.88 万元。

单位: 元

类别	募投项目名称	募集资金承诺投资额	截至 2025 年 3 月 31 日已投入金额
首发募集资金投资项目	模拟集成电路产品开发与产业化项目	360,000,000	364,440,547
	研发中心建设项目	235,000,000	244,765,715
	补充流动资金项目	255,000,000	257,826,384
超募资金投资项目	永久补充流动资金	386,795,700	386,795,700
	车规级模拟芯片研发及产业化项目	685,141,100	438,943,394
	高性能电源芯片研发及产业化项目	291,235,400	259,677,041
金额合计		2,213,172,200	1,952,448,781

注: 部分募投项目已投入金额大于拟投入金额主要系募集资金产生的利息及现金管理收入投入到募投项目中所致。

目前首次公开发行股票的募集资金投资项目已结项, 超募投资项目“车规级模拟芯片研发及产业化项目”和“高性能电源芯片研发及产业化项目”仍在建设中。

### 三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

#### （一）本次部分募投项目延期的具体情况

根据募投项目的实施进度及实际情况，结合公司整体经营发展规划，对“车规级模拟芯片研发及产业化项目”“高性能电源芯片研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

序号	项目名称	项目达到预定可使用状态日期	
		调整前	调整后
1	车规级模拟芯片研发及产业化项目	2025.06.30	2027.12.31
2	高性能电源芯片研发及产业化项目	2025.06.30	2025.12.31

#### （二）本次部分募投项目延期的主要原因及措施

本次募投项目“车规级模拟芯片研发及产业化项目”“高性能电源芯片研发及产业化项目”项目均正常建设实施中，公司秉承合理有效使用募集资金的原则，结合公司产品和技术的研发进度、募集资金投资项目当前实际建设情况、所面临的外部环境及实际经营情况，在募集资金投资项目的推进上更加聚焦，并合理规划项目相关研发投入，募集资金使用进展较原计划有所延后。募集资金投资项目延期有利于公司优化资金的投入产出效果，降本增效，不会对公司正常经营发展产生不利影响。

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。为保证募集资金投资项目实施质量，公司将结合自身发展战略、经营计划及市场情况，积极优化资源配置，充分考虑项目建设周期与资金使用安排，加强对募投项目的管理，定期对项目进行监督检查和评估，有序推进募投项目的后续实施。

### 四、本次调整部分募投项目内部投资结构的具体情况及其原因

#### （一）调整部分募投项目内部投资结构的具体情况

本次拟调整超募项目“车规级模拟芯片研发及产业化项目”内部投资结构，具体情况如下：

单位：元

募投项目名称	类别	调整前	调整后
		募集资金承诺投资金额	募集资金承诺投资金额
车规级模拟芯片研发及产业化项目	软硬件投入	123,267,000	54,657,236
	研发投入	515,417,500	576,107,309
	租赁及装修投入	46,456,600	54,376,555
	合计	685,141,100	685,141,100

## （二）调整部分募投项目内部投资结构的原因

公司根据募投项目实施情况及实际业务发展运营的需要，在募集资金投资用途、投资总额均不变以及使用期限延长的前提下，拟调整超募投资项目“车规级模拟芯片研发及产业化项目”内部投资结构，增加研发、租赁及装修的投入金额，减少软硬件的投入，有利于公司将更多募集资金支持车规产品研发，提升资金使用效率，推动募投项目实施进展。

## 五、本次部分募投项目延期及调整内部投资结构对公司的影响

本次部分募投项目延期及调整内部投资结构是公司根据项目的实际投资情况和进度作出的审慎决定，有利于募集资金投入结构的优化及募投项目的稳步实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司本次募投项目延期以及内部投资结构调整未改变募投项目的实施主体、投资规模和资金用途，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规的规定，符合公司长期发展规划。

## 六、监事会及保荐机构意见

### （一）监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期并调整内部投资结构，是根据公司募投项目的实际进展及未来规划做出的谨慎决定，符合公司实际情况，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意此次对部分募集资金投资项目进行延期并调整内部投资结构事项。

### （二）保荐机构意见

经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：公司本次部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序。本次部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构事项不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科

创业板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定。综上，对公司本次部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构事项无异议。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2025年4月29日